



JCU CORPORATION

# 第64期・2024年3月期 第2四半期決算説明資料

株式会社JCU

東証プライム 4975

2023年11月7日(火)

【2Q 累計会計期間】 JCU（単体） ⇒ 2023.4～2023.9  
海外子会社 ⇒ 2023.1～2023.6

## 薬品事業

### 分野向け 電子

- 中国は一部のプリント基板メーカーにおいて回復基調がみられるものの、スマートフォンをはじめとする高機能電子デバイス向けプリント基板の需要が減少し、薬品売上高は減少
- 台湾はサーバー、高機能電子デバイス向け半導体パッケージ基板の需要が減少し、薬品売上高は減少
- 韓国は半導体市場の低迷が継続し、半導体パッケージ基板の需要が減少し、薬品売上高は減少

### 分野向け 自動車

- 日本は半導体・部品不足が緩和されたことにより、自動車の生産台数が回復基調となりましたが、薬品売上高は横ばいに推移
- 中国は半導体・部品不足の緩和に伴い、自動車の生産・販売台数は増加したものの、当社が対象とする自動車部品の需要が減少し、薬品売上高は減少

## 装置事業

- 新型コロナウイルス感染症の影響による先送り案件の再開及び新規投資需要の増加により、売上高は増加、受注残高は大幅に増加

# 2024年3月期2Q累計 連結実績



(単位：百万円)

	2022年3月期 上半期	2023年3月期 上半期	2024年3月期 上半期		
	実績	実績	予想	実績	対前年増減率
売上高	11,654	13,117	10,700	10,864	△17.2%
営業利益	4,350	4,680	2,590	3,095	△33.9%
経常利益	4,430	4,720	2,590	3,202	△32.2%
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	3,078	3,326	1,750	2,177	△34.5%
1株当たり 四半期純利益	117円30銭	128円26銭	68円29銭	85円04銭	—

為替感応度（連結年換算）：上記主要通貨 1%の変動で、連結営業利益 1.05億円程度

(単位：円)

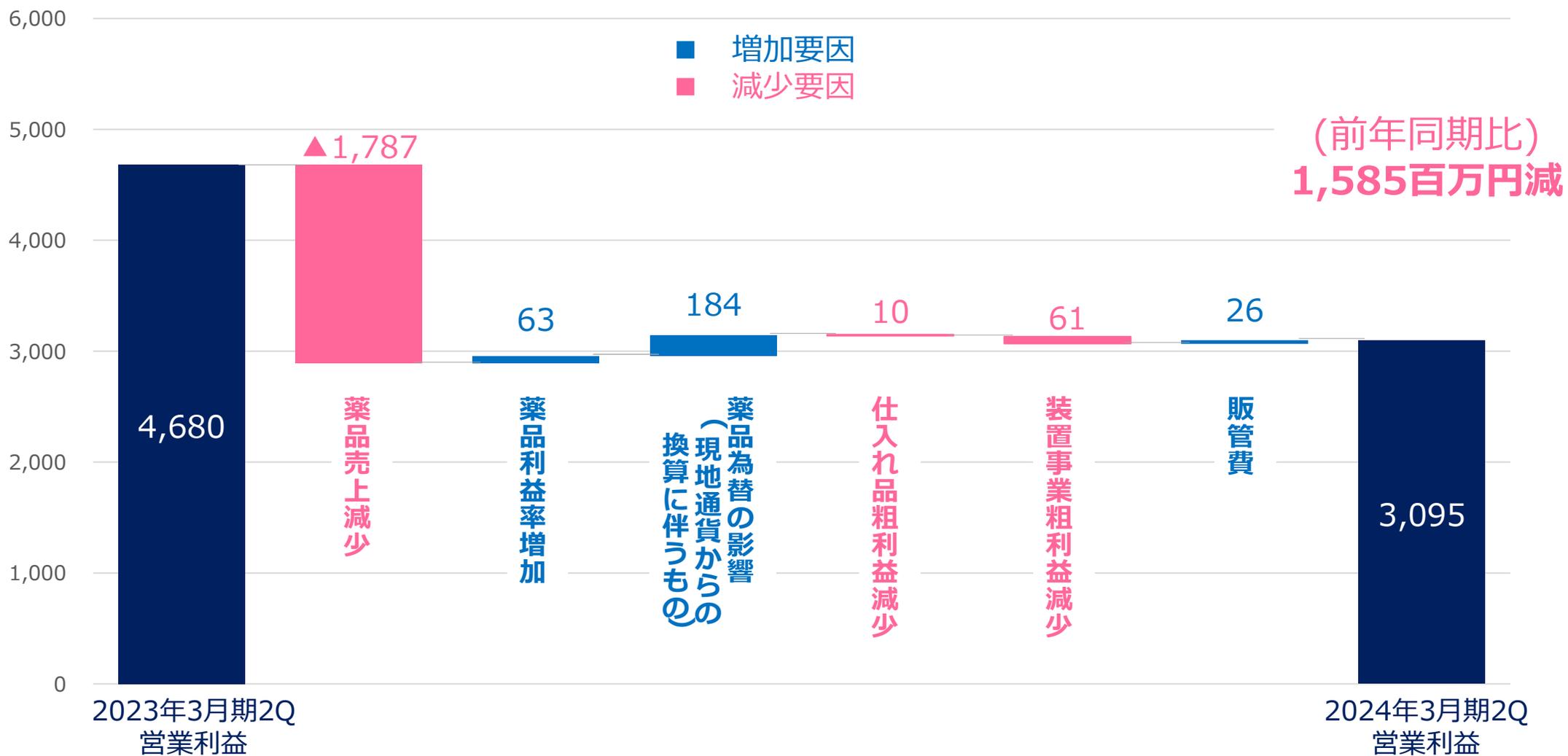
	2023年3月期				2024年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q (期首予想)	2Q
中国 人民元 ( C N Y )	18.29	18.93	19.35	19.48	19.34	19.45
台 湾 ド ル ( T W D )	4.15	4.28	4.37	4.41	4.36	4.42
韓 国 ウ オ ン ( K R W )	0.0964	0.0996	0.1008	0.1017	0.1039	0.1042

(注) 当社の主要な外国通貨は、中国 人民元・台湾ドル・韓国ウォンであり、いずれも、期中平均レートを採用しております。

# 2024年3月期2Q 連結営業利益 増減内容



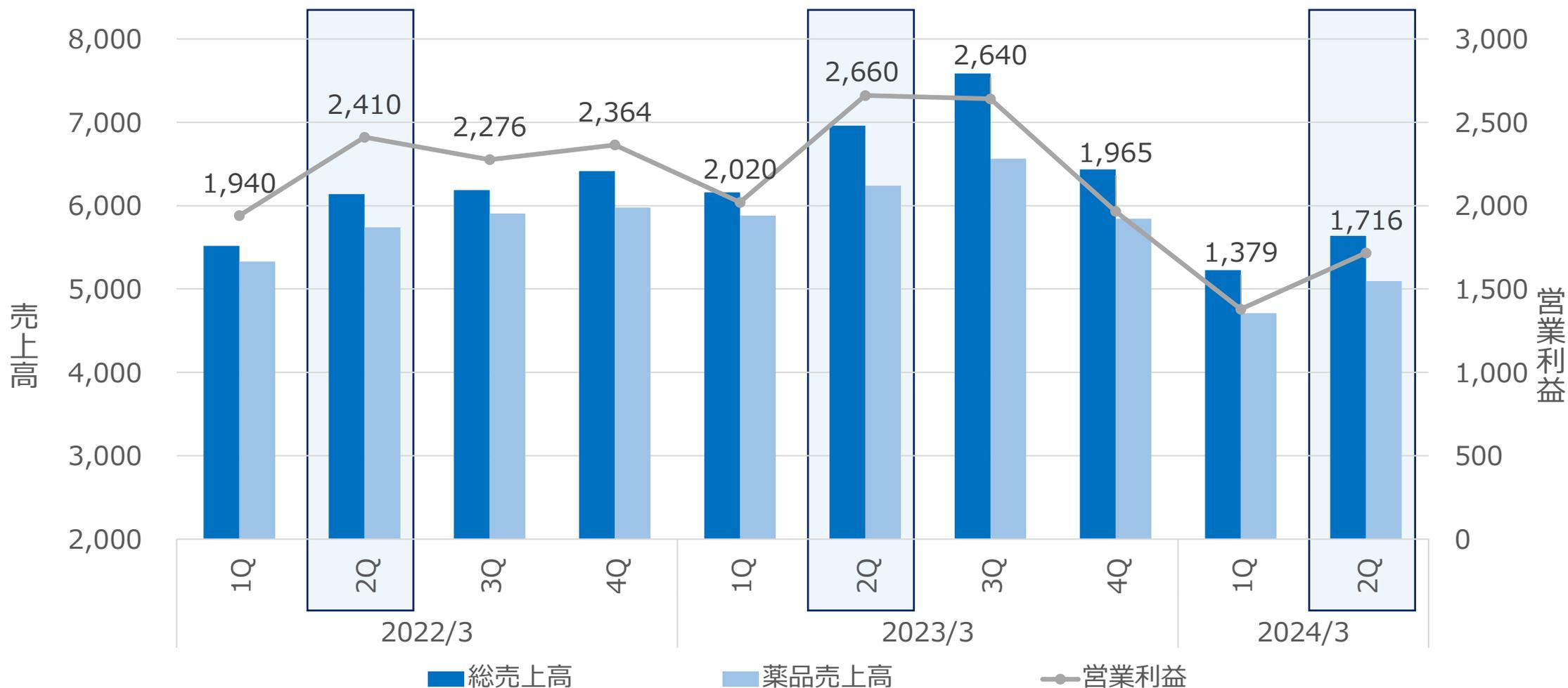
(単位：百万円)



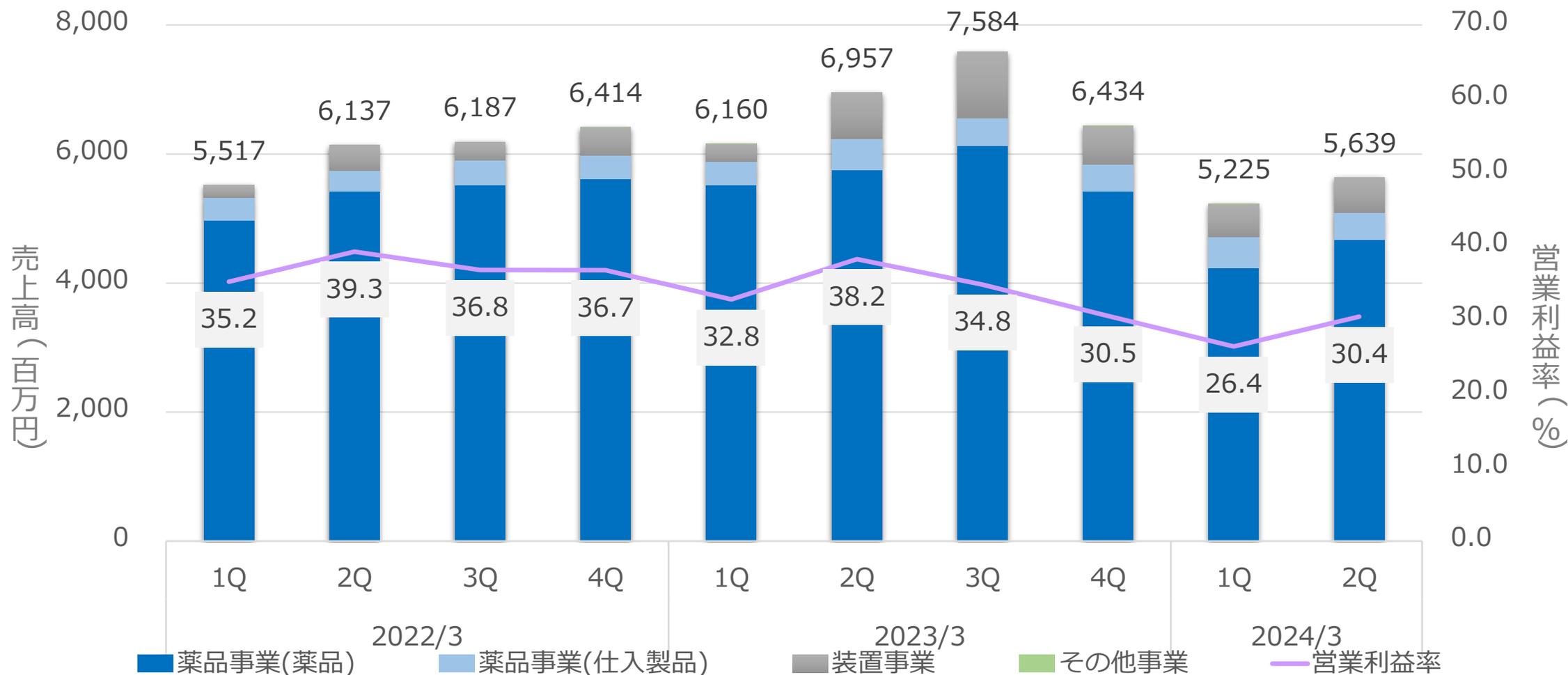
# 四半期別 連結業績の推移



(単位：百万円)



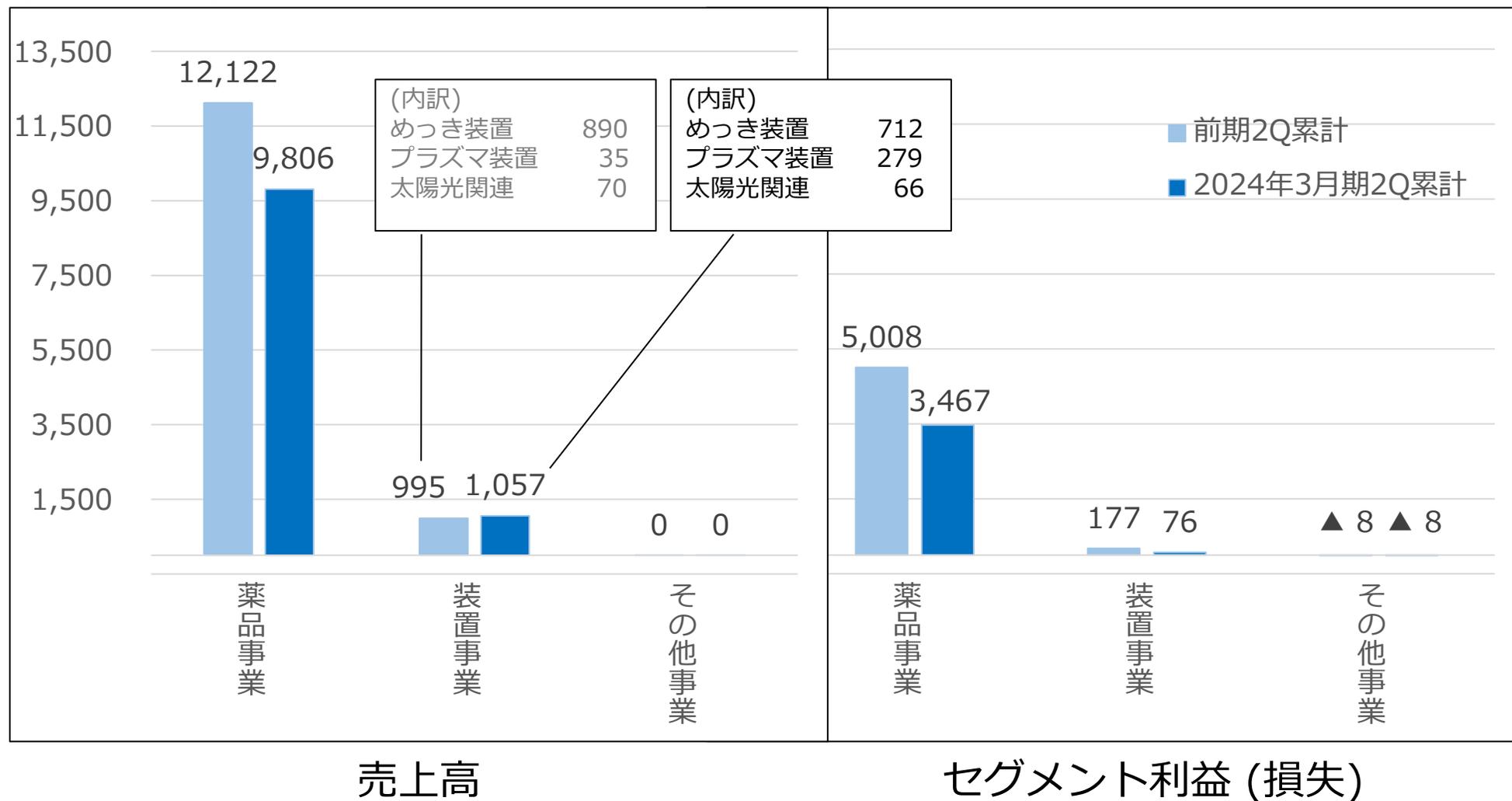
# 四半期別 連結業績の推移(セグメント別)



# 2024年3月期2Q 連結セグメント業績



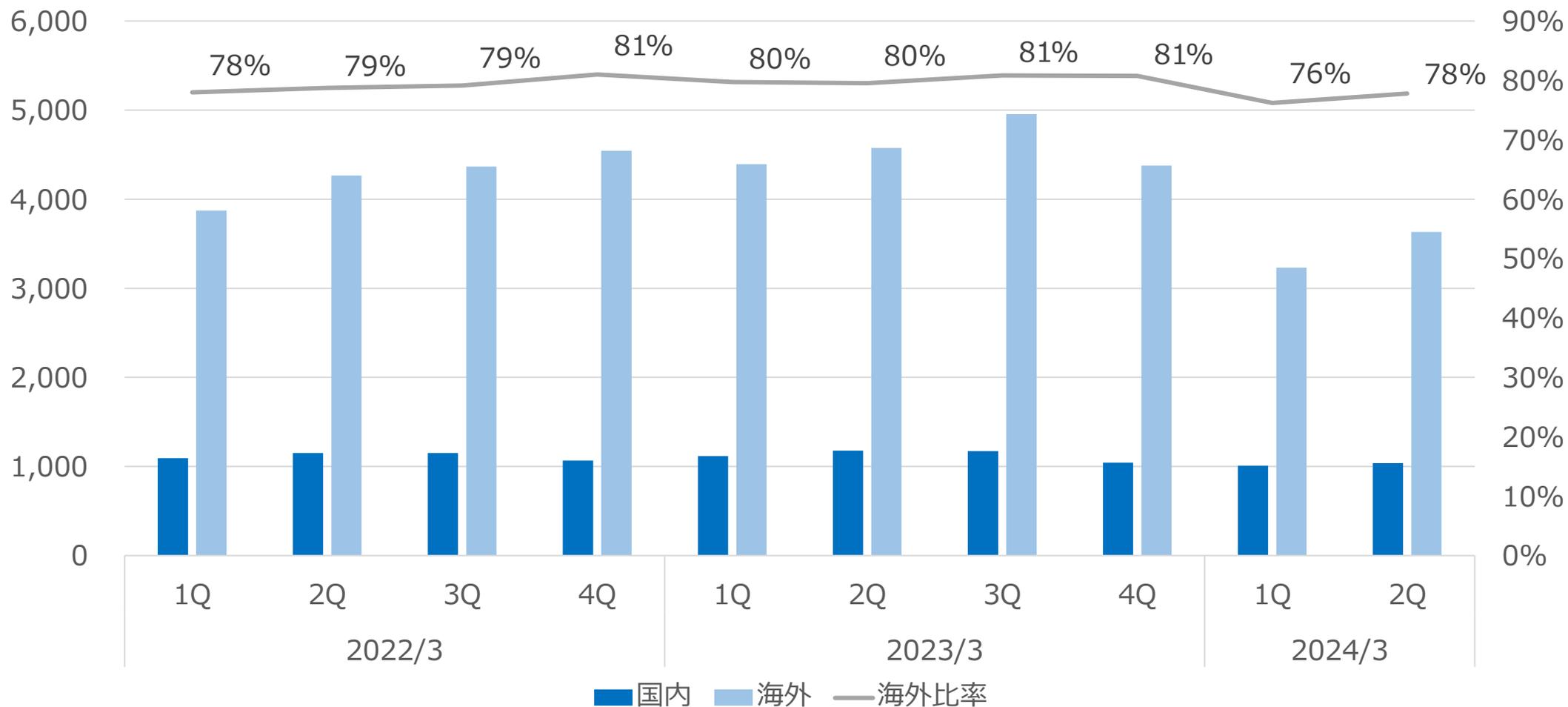
(単位：百万円)



# 四半期別 国内外薬品売上高推移



(単位：百万円)



# POP, ビアフィリング, エッチング用薬品 | 四半期別 売上高推移

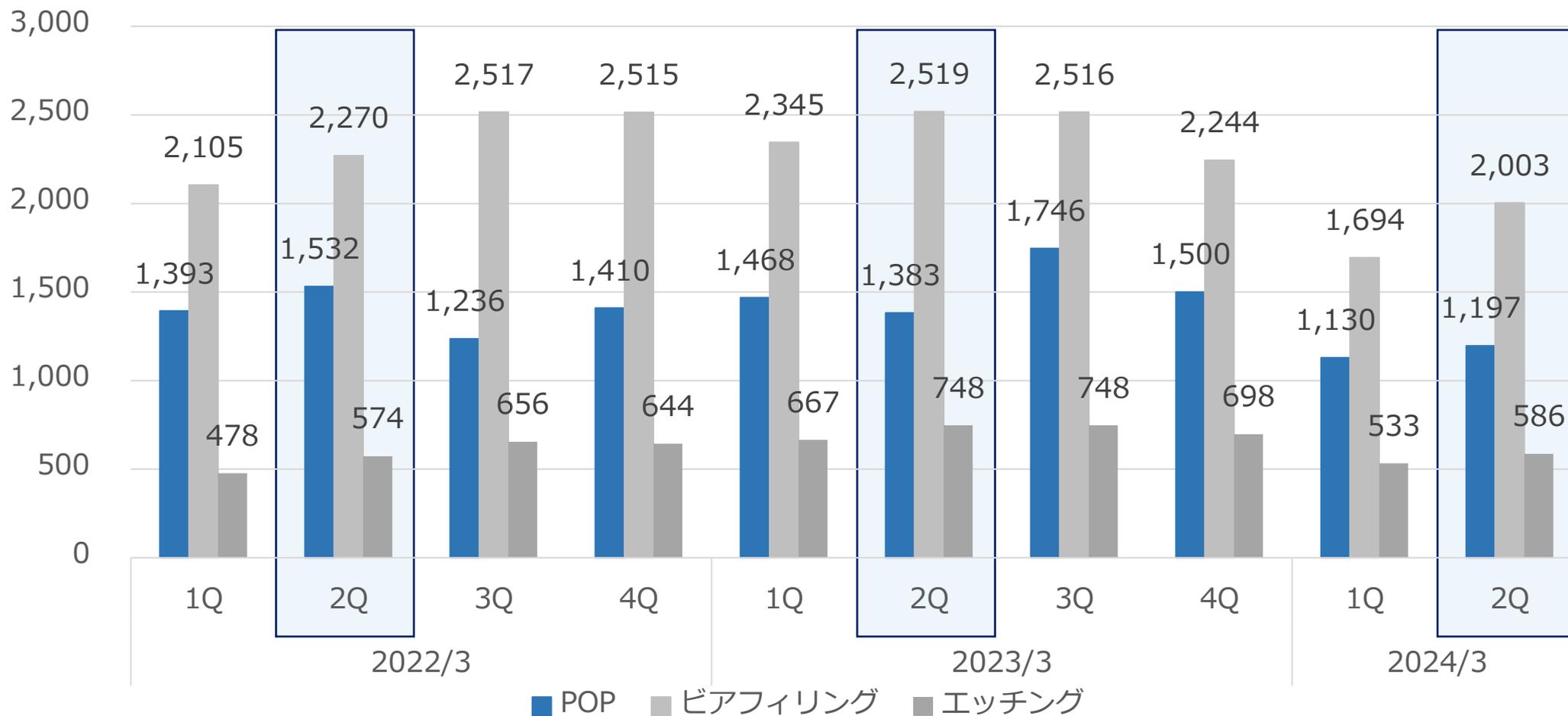


POP (Plating on Plastics)・・・プラスチック上へのめっきで、主に自動車部品向け

ビアフィリング・・・プリント基板および半導体パッケージ基板向けの銅めっき用添加剤、主にスマートフォン、PC向け

エッチング・・・プリント基板および半導体パッケージ基板向けのエッチング用添加剤、主に、PC、通信IC向け

(単位：百万円)



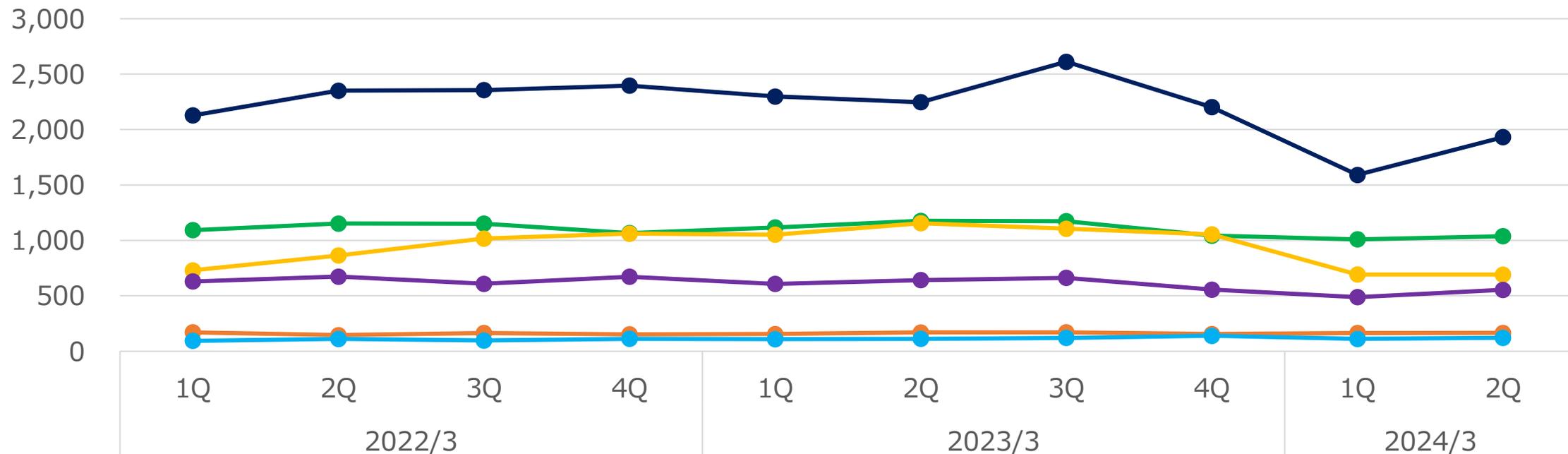
■ POP ■ ビアフィリング ■ エッチング

2024年3月期 第2四半期決算説明資料

# 四半期別 地域別薬品売上高の推移



(単位：百万円)



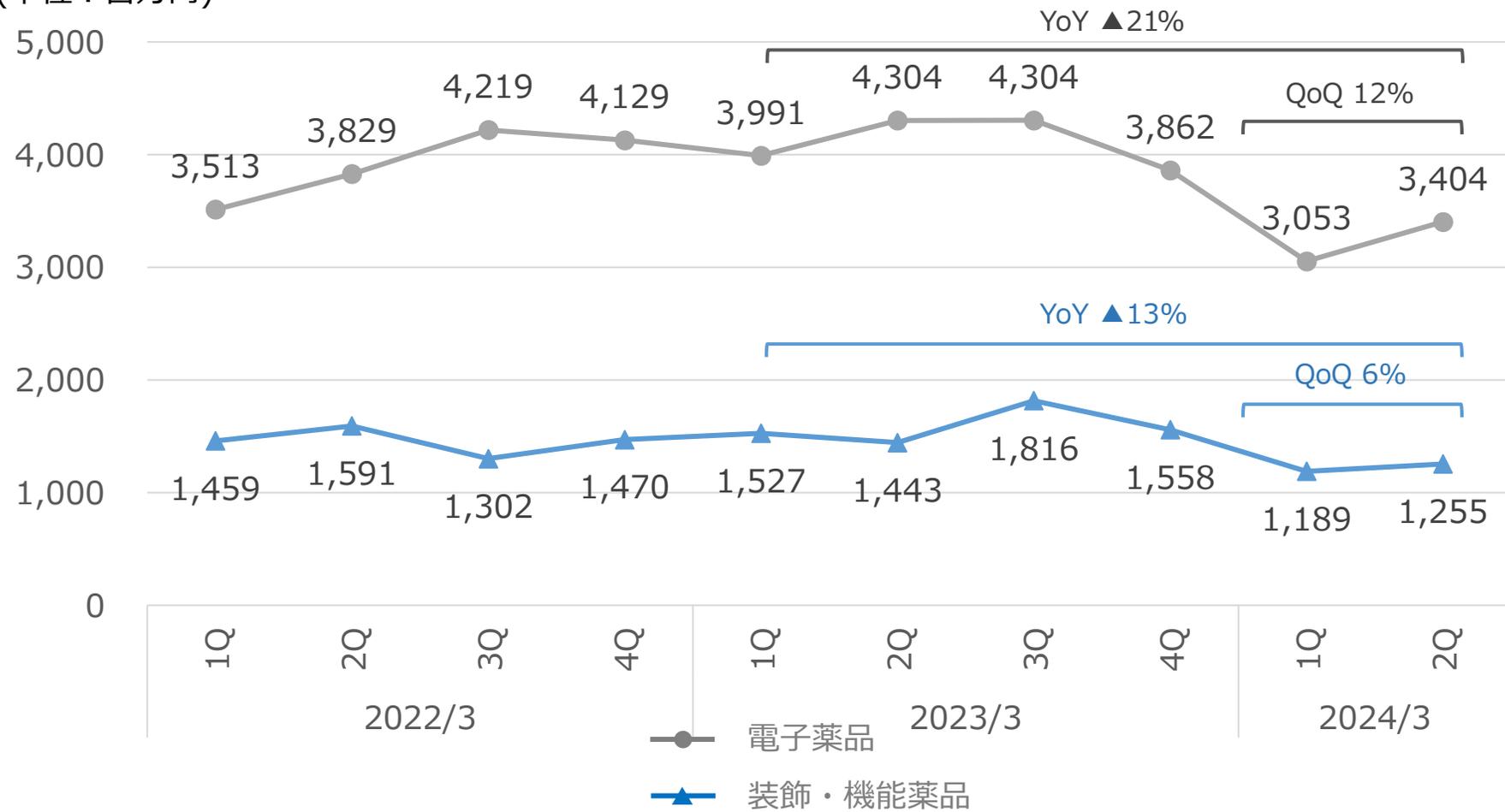
	2022/3				2023/3				2024/3	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
● 日本	1,092	1,152	1,150	1,166	1,117	1,177	1,173	1,043	1,009	1,038
● 中国	2,133	2,353	2,359	2,391	2,307	2,247	2,612	2,203	1,591	1,931
● 台湾	732	864	1,018	1,060	1,052	1,155	1,106	1,054	692	691
● 韓国	629	673	608	672	607	641	662	556	488	553
● タイ	170	145	164	152	156	170	170	155	164	166
● ベトナム	94	111	97	112	109	112	120	139	111	121

# 四半期別 地域別薬品売上高の推移



## 連結

(単位：百万円)



(電子薬品) 主力製品：ビアフィリング  
 プリント基板、コネクタ、  
 半導体分野向けの表面処理(めっき)薬品

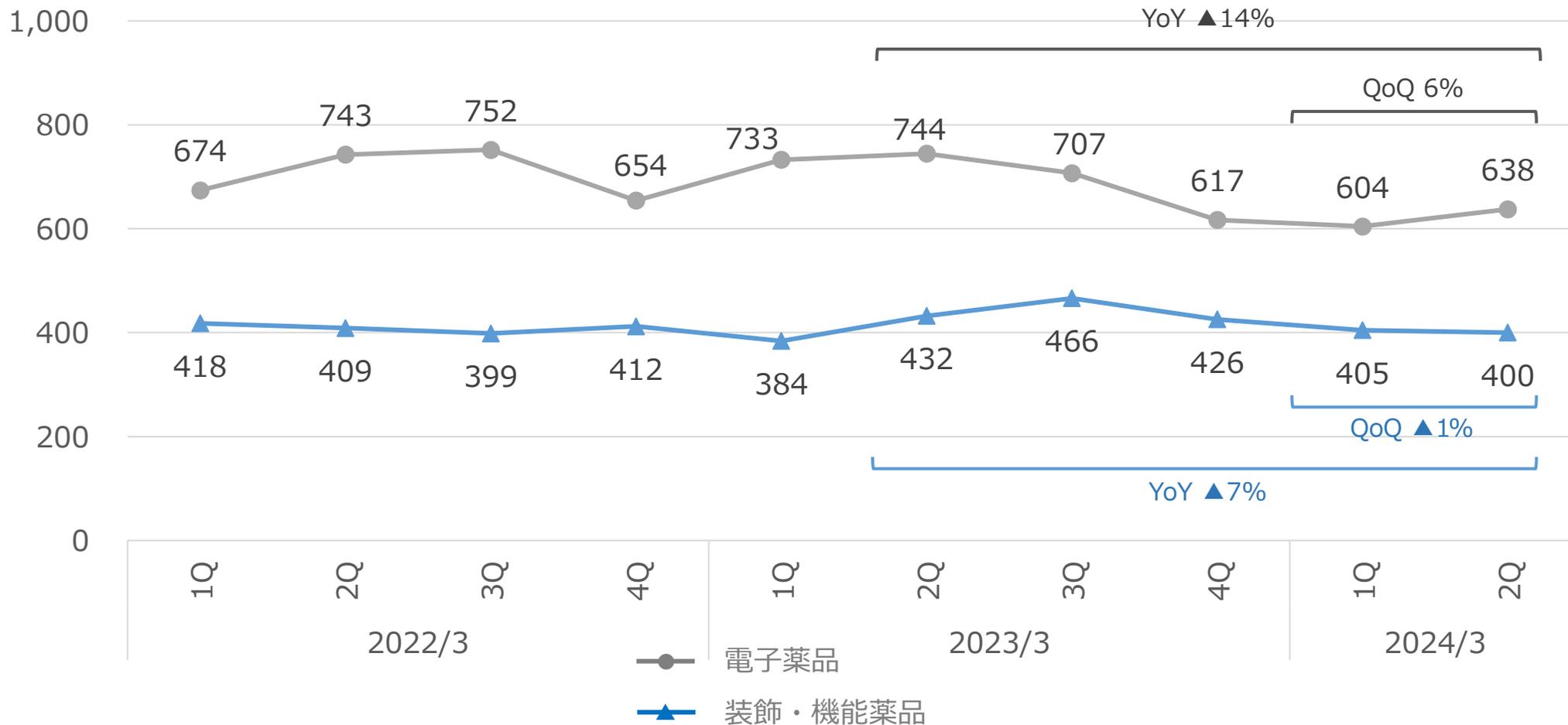
(装飾・機能薬品) 主力製品：POP  
 装飾、防錆分野向けの薬品  
 主に自動車部品、水栓金具等の  
 表面処理(めっき)薬品

# 四半期別 地域別薬品売上高の推移



## 国内

(単位：百万円)

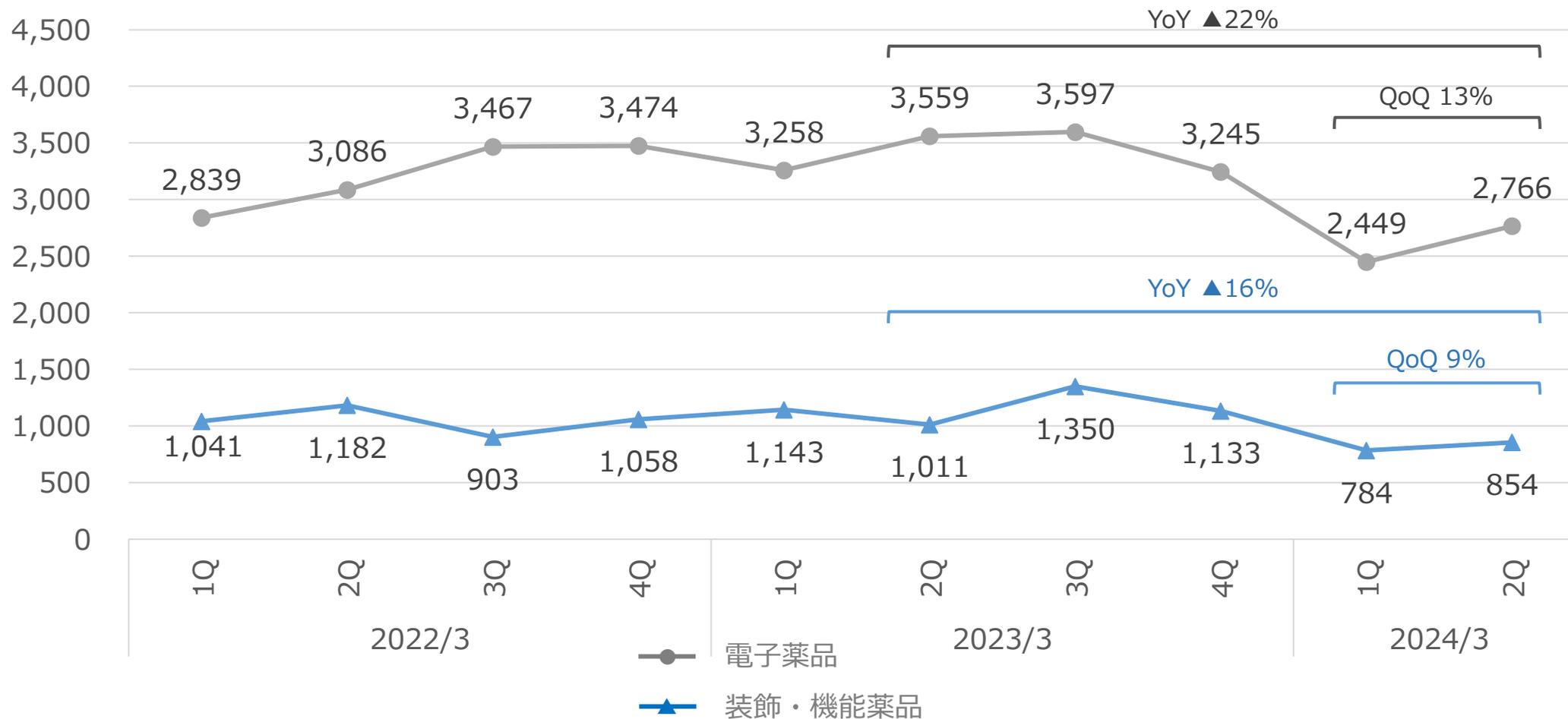


# 四半期別 地域別薬品売上高の推移



## 海外

(単位：百万円)

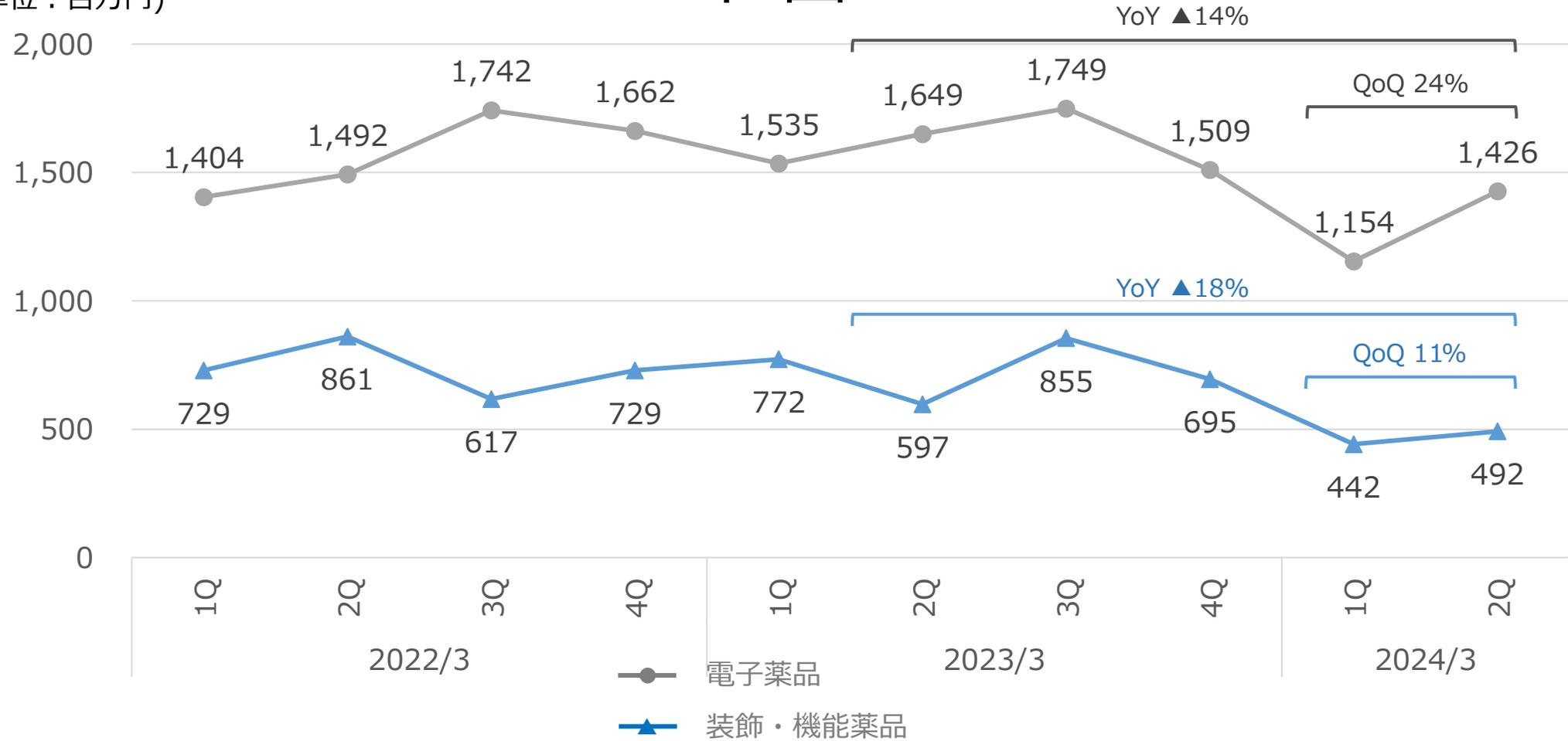


# 四半期別 地域別薬品売上高の推移



## 中国

(単位：百万円)

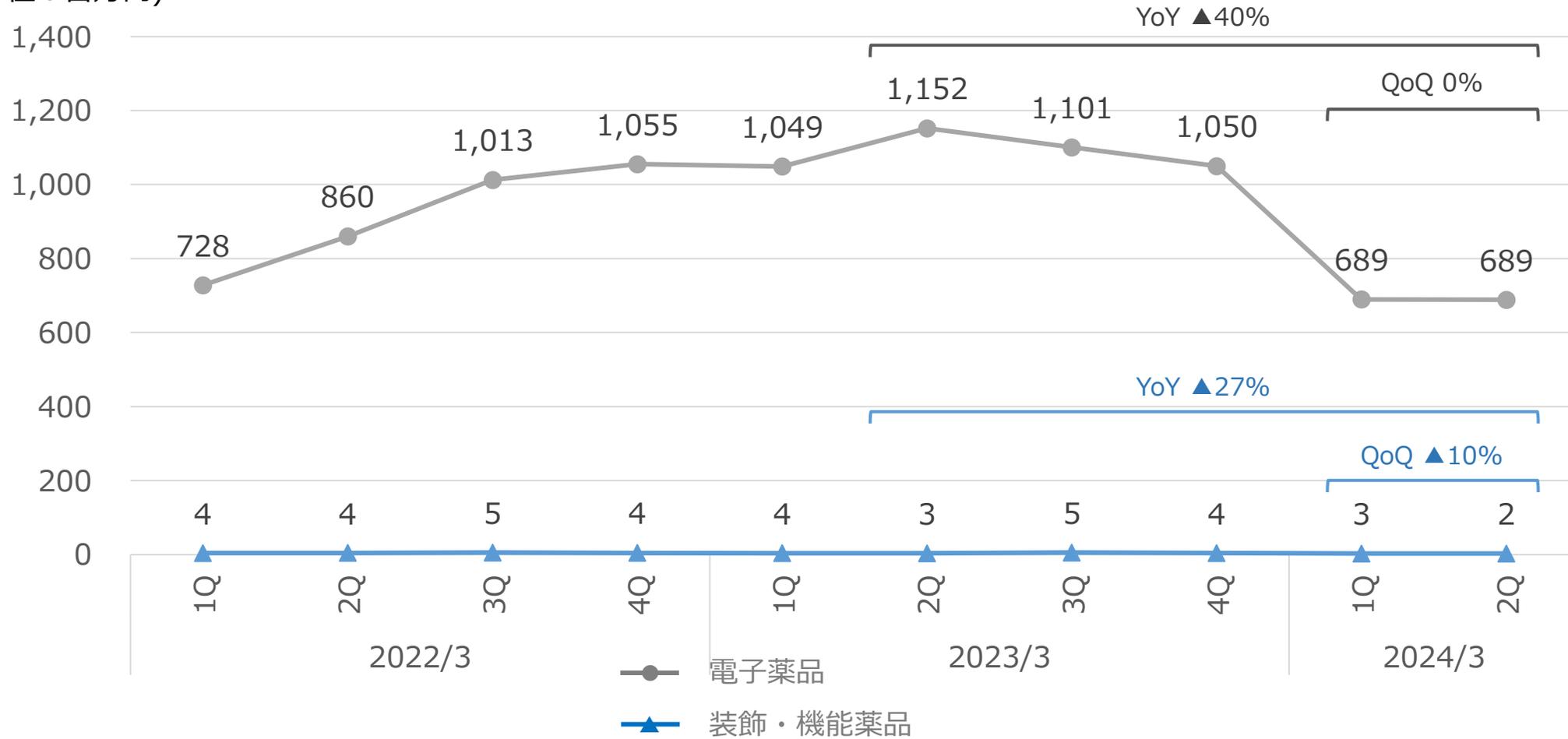


# 四半期別 地域別薬品売上高の推移



## 台湾

(単位：百万円)

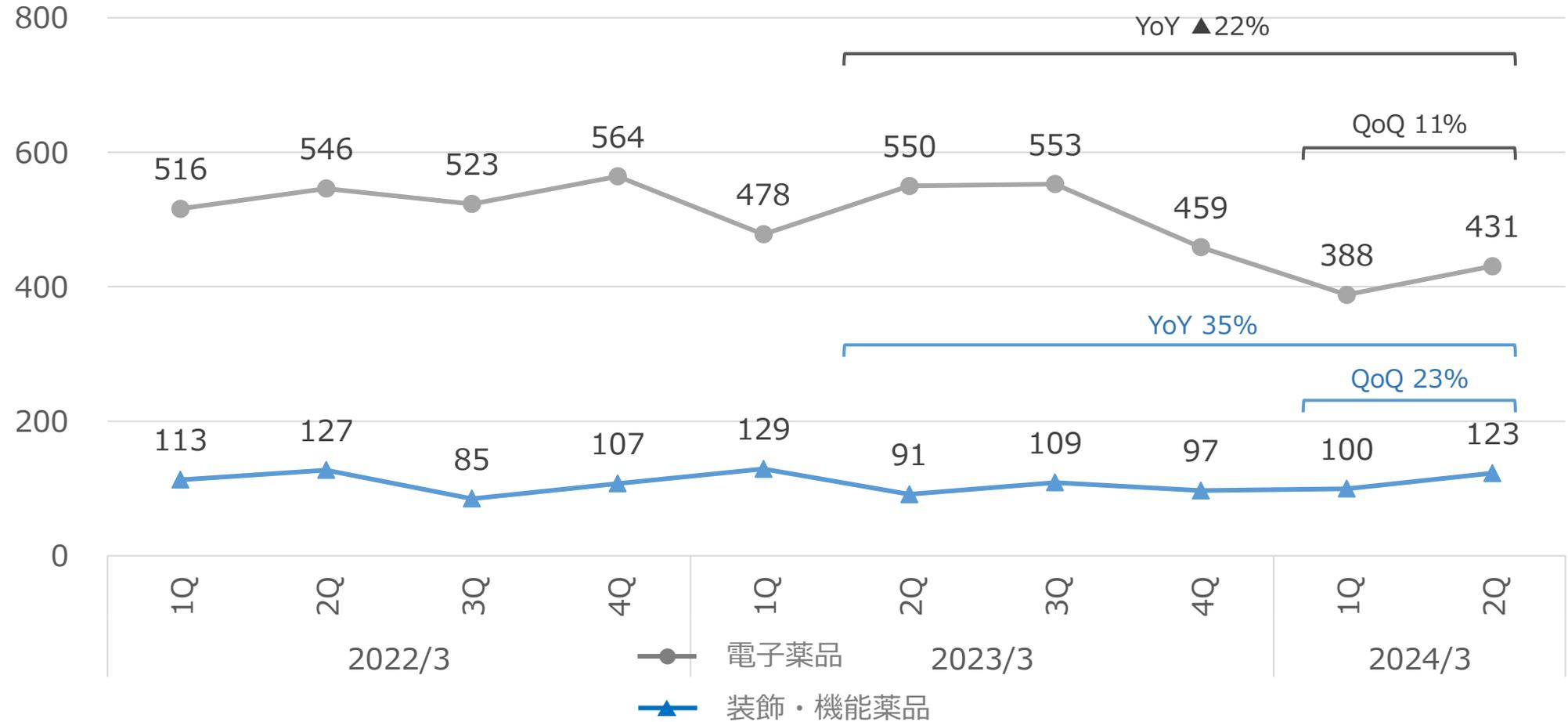


# 四半期別 地域別薬品売上高の推移



## 韓国

(単位：百万円)



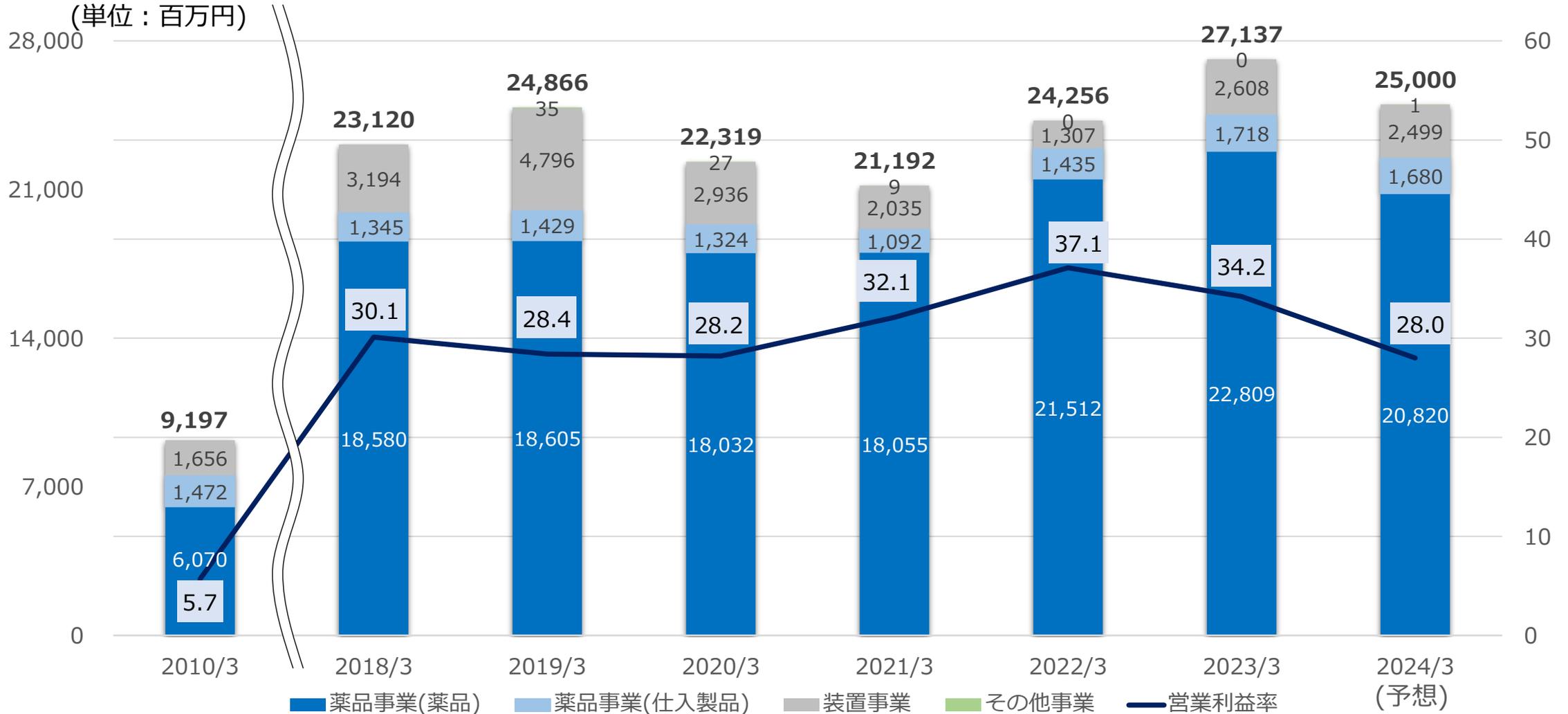
# 2024年3月期 業績予想



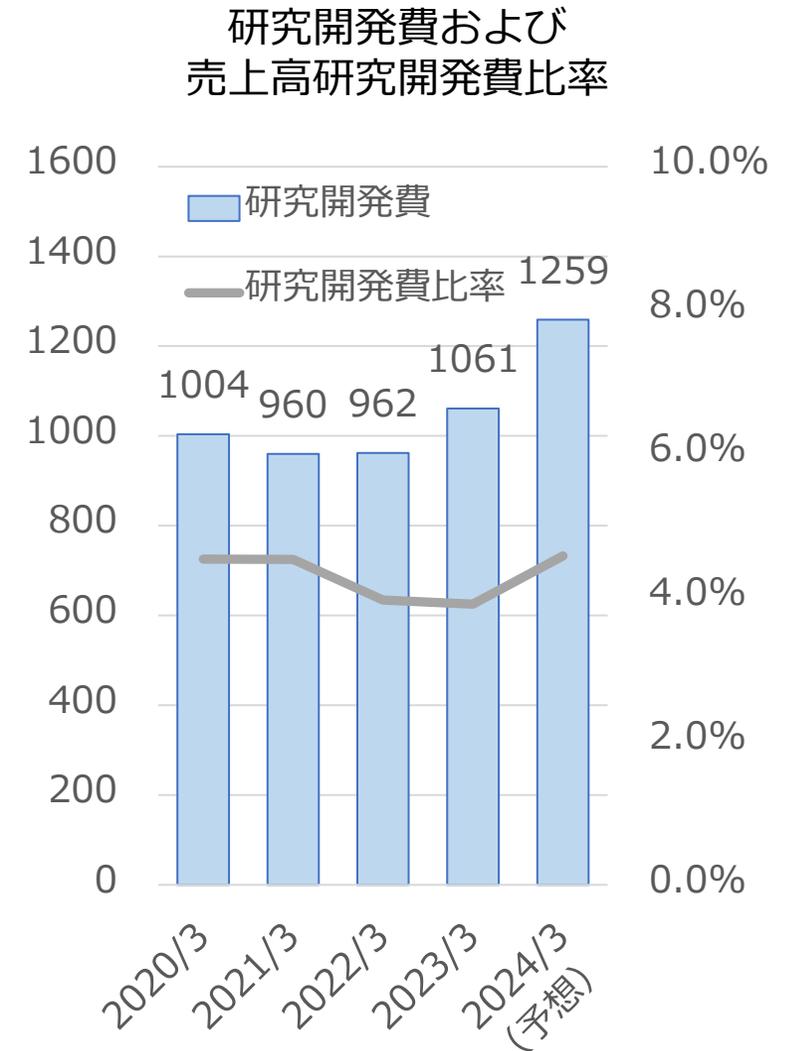
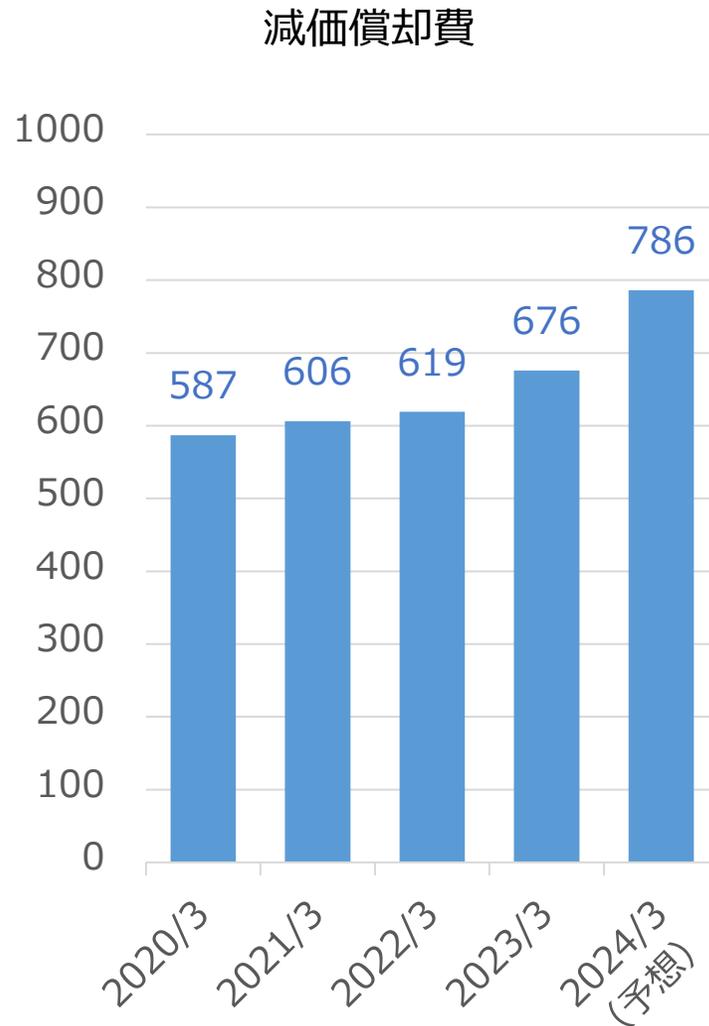
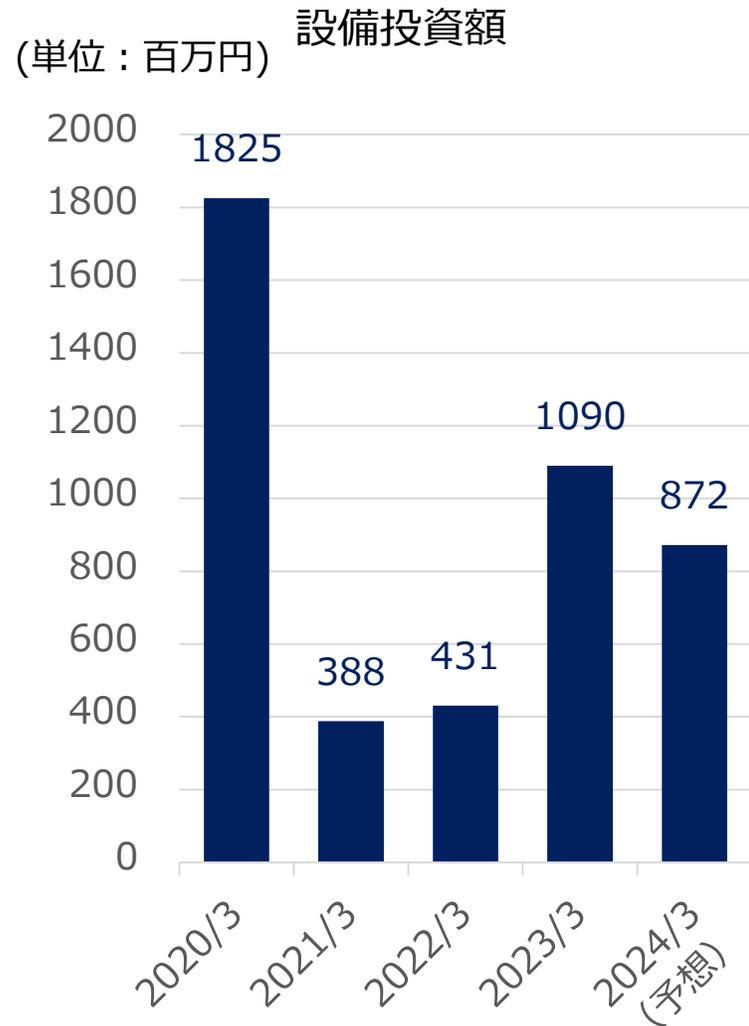
(単位：百万円)

決算期	2023年3月期 通期 実績	2024年3月期 上半期 実績	2024年3月期 通期 予想	通期予想に 対する進捗率
売上高	27,137	10,864	25,000	43.5%
営業利益	9,285	3,095	7,000	44.2%
経常利益	9,369	3,202	7,000	45.7%
親会社株主に 帰属する 四半期純利益	6,103	2,177	4,800	45.4%
1株当たり 四半期純利益	232円62銭	85円04銭	187円81銭	—

# 年度別セグメント別売上高推移 (予想)



# 設備投資額、減価償却費および研究開発費



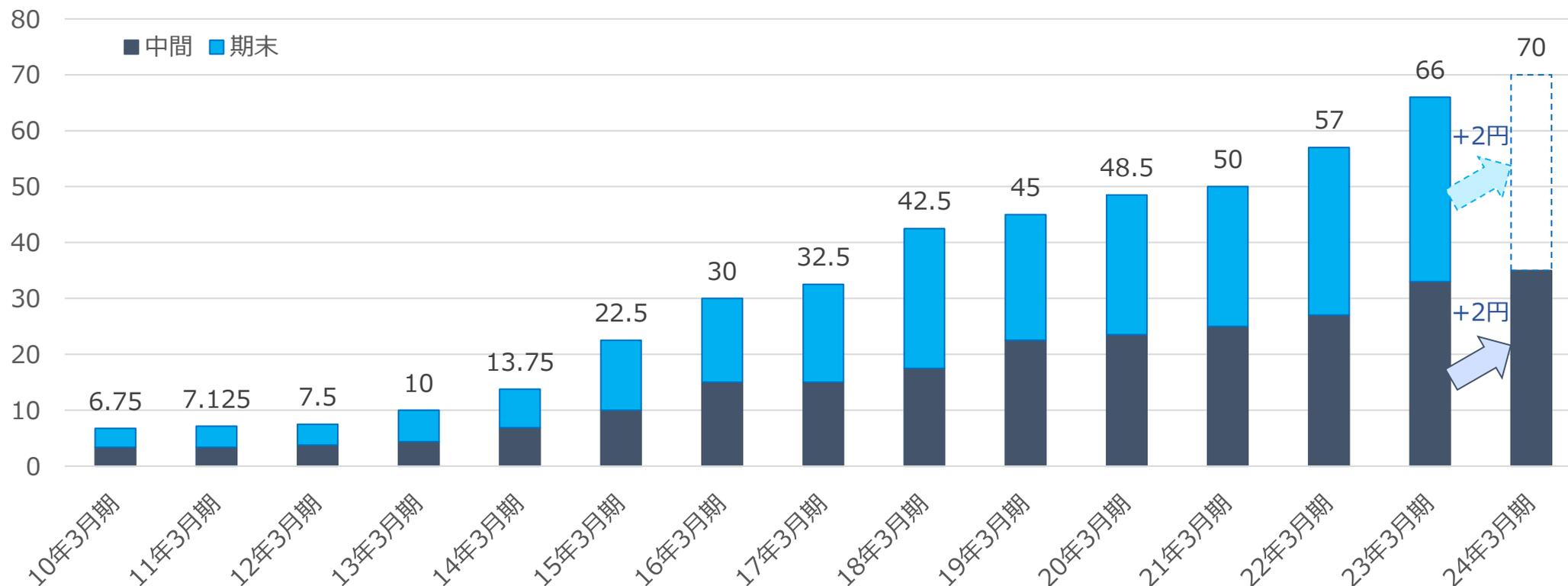
# 2024年3月期 配当予想



1株当たりの配当金  
(予想)

中間配当金：35円  
期末配当金：35円

14期連続増配予定



当社は、持続的な成長を達成するため手元流動性を確保し、安定した財務基盤を維持しつつ、成長投資を継続してまいります。配当は、安定増配基調継続を目指し、機動的な自己株式の取得による株主還元の実施を基本方針としております。

当社グループは、ESGに配慮した課題に事業活動を通じて取り組み、持続可能な成長を続けるグローバル企業を目指してまいります。

## Environment



### 環境配慮型製品の開発

- スタンブ式めっき処理装置および薬品
- 低環境負荷化学ニッケルめっきプロセス
- 低環境負荷装飾用硫酸銅めっきプロセス



### CO<sub>2</sub>排出量（単体）

1,057 t-CO<sub>2</sub>【2023年3月期末】  
※2013年度比27%削減

## Social



### 女性管理職比率（単体）

11.3%【2023年3月期末】



### 国内外拠点のISO9001取得状況

7か国12拠点【2023年3月期末】  
※日本、中国、台湾、韓国、タイ  
ベトナム、メキシコ

## Governance



### 企業統治の体制

- 取締役  
社内：6名、社外：4名（内、女性1名）
- 監査役  
常勤：1名、社外：3名（内、女性1名）

- 会社概要 & 新拠点について
- 今後必要とされる表面処理技術
- 主な商流
- 主な製品
- 薬品用途説明 最終製品例

# 会社概要



創業	:	1957年 12月
設立	:	1968年 4月 1日
資本金	:	12億6,692万円
年商	:	単体 126億円      連結 271億円      (2023年3月期末)
本社所在地	:	東京都台東区東上野 4-8-1 TIXTOWER UENO 16階
業務内容	:	表面処理薬品、表面処理装置及び関連資材の製造・販売
代表者	:	代表取締役社長兼CEO      木村 昌志
従業員数	:	単体 238名      連結 544名      (2023年3月期末)

## ISO認証取得

ISO9001      生産本部・本社営業部・総合研究所      JCQA-0281

ISO14001      生産本部・総合研究所      JCQA-E-0143

2024年3月期 第2四半期決算説明資料

# 新拠点（マレーシア）の開設について



マレーシアは半導体関連企業の大型投資が相次いでおり、半導体関連の表面処理薬品および装置の販売を開始  
JCUの東南アジア地域の拠点はタイ、ベトナム、インドネシアに次いで4カ国目

会社名	JCU MALAYSIA SDN. BHD.
所在地	631, Jalan Seraya 3/7, Pusat Perniagaan Seraya, 09000 Kulim, Kedah.
設立	2022年9月30日
事業開始	2023年3月13日 (開所式 2023年5月22日)
事業内容	表面処理薬品、表面処理用装置および 関連資機材の製造・販売



# 今後必要とされる表面処理技術 – 電子分野 –

## ターゲット

高機能電子デバイス、通信インフラ、カーエレクトロニクスなどの次世代IC-PKG基板

注力すべき表面処理技術

ビアフィリング  
めっき技術

エッチング技術

### ①面内均一性向上

これまで



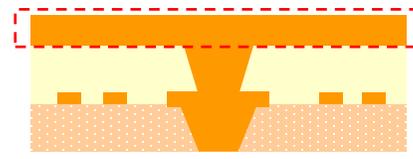
銅配線の高さが不均一

今後の技術

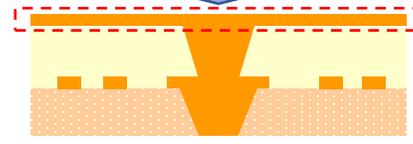


銅配線の高さが均一

### ②薄膜埋まり性向上



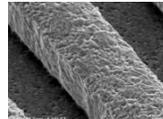
穴を埋める際、表層膜厚が厚くなる



穴を埋める際、表層膜厚を薄くする

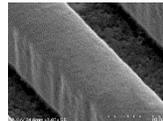
### ③矩形性維持&平滑性向上

これまで



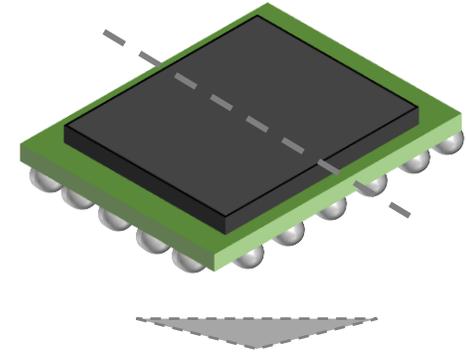
エッチング後の銅配線表面が粗れて凹凸ができる

今後の技術

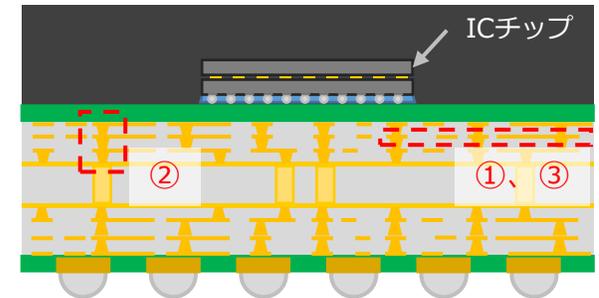


エッチング後の銅配線表面が滑らかな状態を維持できる

### 半導体パッケージ基板の模式図



### 半導体パッケージ基板の断面図



# 今後必要とされる表面処理技術 – 装飾・機能分野 –

ターゲット

自動車部品（フロントグリル、ドアハンドル、エンブレム等）、  
水栓部品（シャワーヘッド、排水栓等）

注力すべき表面処理技術

低環境負荷  
表面処理技術

## ①環境規制物質不使用の代替プロセス

これまで



人体に有害とされる  
6価クロムイオン

使用される工程

- ・前処理
  - エッチング
- ・後処理
  - めっき
  - 電解化成処理

今後の技術

Cr<sup>6+</sup>フリー

全工程で人体に有害とされる  
6価クロムイオンを使用しない  
環境配慮型プロセスの展開

各種めっき後の  
外観写真



## ②低環境負荷装飾用銅めっきプロセス



染料系銅めっき用  
添加剤

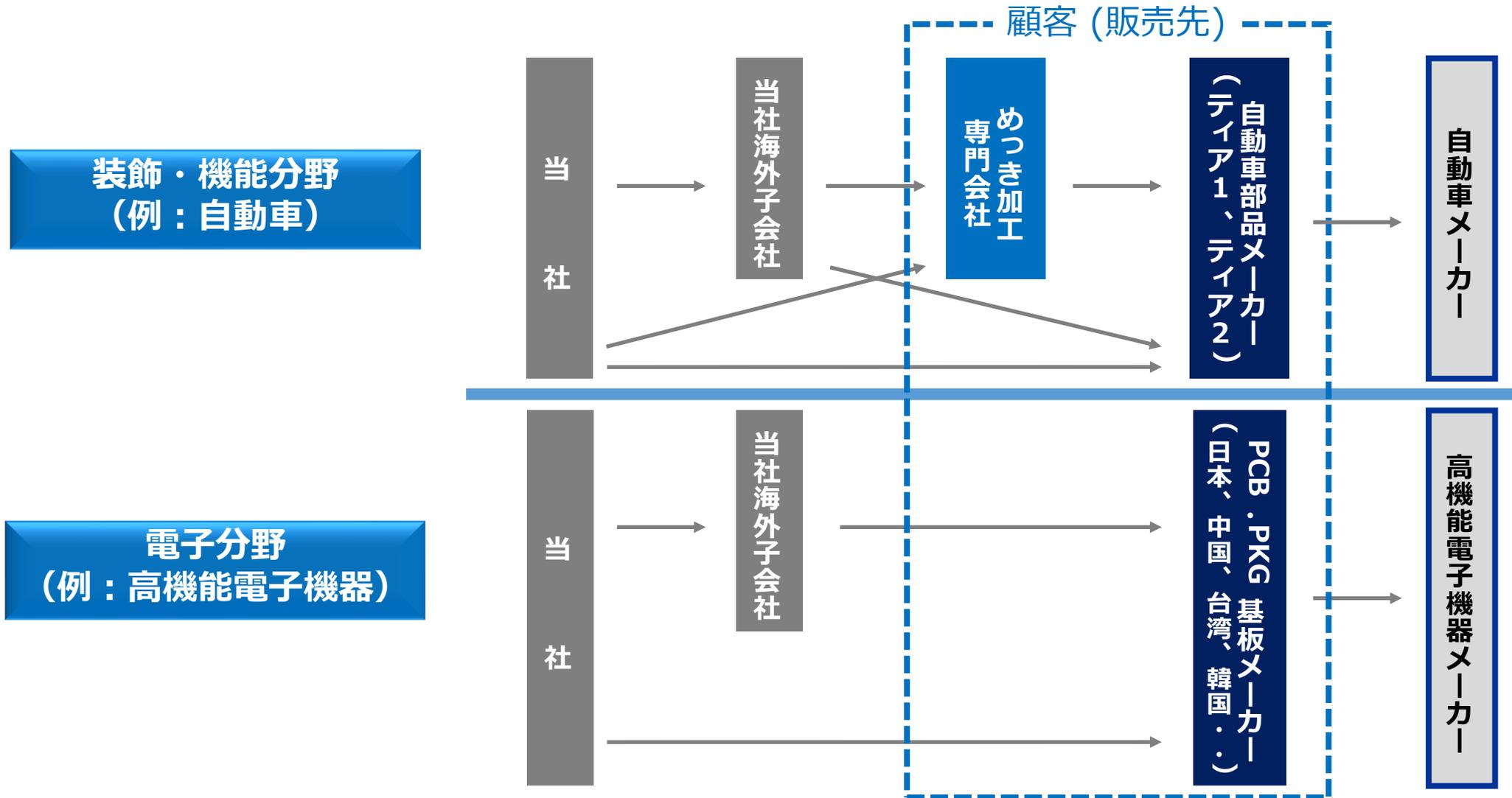
製造工程で環境負荷の  
高い薬品を使用

低環境負荷

環境に負荷がかかる薬品を使用せず、  
従来と同等の性能を実現する  
非染料系銅めっき用添加剤を開発



# 主な商流

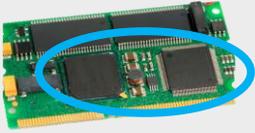


# 主な製品



薬品事業	装飾・機能分野向け (基幹薬品)	自動車部品（フロントグリル、ドアハンドル、エンブレム等） 水栓金具（給水機器、シャワーヘッド、排水栓等） 建築部品（ボルト、ナット等）
	電子分野向け (電子薬品)	プリント基板（両面板、多層板、ビルドアップ基板、パッケージ基板等） 電子部品（リードフレーム、チップ部品、コネクタ等） 半導体（シリコンウエハー）
装置事業	全自動表面処理装置	素材の投入からめっきの完成まで自動運転をする装置
	付帯機器	表面処理装置に付随する、ろ過機等の付帯機器の製造販売
	自動分析管理装置	めっき液の濃度を分析し不足分を補給して、自動で管理する装置
	プラズマ装置	プリント基板のめっき前処理用等の洗浄処理装置

# 薬品用途説明 最終製品例

用語説明		最終製品
機能・装飾薬品	装飾・防錆分野向け、金属外観の付与、サビ防止などの機能性付与のための表面処理(めっき)薬品。	自動車部品、水栓金具、建築部品
POP薬品 (Plating on Plastics)	基幹薬品の主力製品 プラスチック上へ金属膜をめっきするための薬品 	(自動車部品) フロントグリル、エンブレム など (水栓金具) シャワーヘッド、水栓コック など
その他基幹薬品	銅・鉄鋼などの金属素材へ金属膜をめっきするための薬品	(建築部品) ネジ、蝶番 など
電子薬品	電子信号を流すための回路、電子部品の電気接点などプリント配線板を製造するためのめっき薬品	5G関連部品、データセンター等のインフラ、高機能電子デバイス
ビアフィル薬品 (プリント基板/マザーボード向け)	電子製品に内蔵される プリント基板/マザーボードに 配線を形成するための銅めっき薬品 	(5G関連部品) 5G基地局、車載基板、スマート家電 など
ビアフィル薬品 (半導体パッケージ(PKG)基板向け)	半導体チップを外部環境から保護し、 プリント基板に実装するための 基板(半導体PKG基板)に、配線を 形成するための銅めっき薬品 	(データセンター等のインフラ) 通信サーバー向けマザーボード など  (高機能電子デバイス) スマートフォン、PC、タブレット、ゲーム機器 など
その他電子薬品	マザーボード、または半導体PKG基板に配線を形成する際、不要な銅を削るためのエッチング薬品 コネクタ、リードフレーム用のめっき薬品など	

この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは異なる場合があります、この資料はその実現を確約したり、保証するものではありません。

当社ホームページ：  
<https://www.jcu-i.com/>

お問い合わせ先：経営戦略室  
Email： [ir2@jcu-i.com](mailto:ir2@jcu-i.com)  
TEL： 03-6895-7004